



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Anexa 4

Nr. 5828/1/THINKSENSE/17.06.2026

A N U N Ț

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de sistem privind selecția și încadrarea personalului pe posturi în afara organigramei, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4003/09.05.2025, având în vedere aprobarea cererii de finanțare aferentă proiectului “Towards Higher INvolvement of Knowledge Significantly Enhancing Nearer for Sustainable Europe” (“THINKSENSE”), prin contractul de finanțare nr. RUE 7.PI/I4/C9, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, program flexibil și timp inegal de lucru, a următoarelor posturi vacante, în cadrul proiectului menționat:

Poziția postului conform deciziei	Funcție	Presupune activități cu elevi/ studenți	Nr. posturi	Tarif orar brut (lei)	Perioada propusă pentru încheierea CIM	Timpul de lucru (ore/lună)
C25	Cercetător Științific gradul I_4	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	250	15.07.2026-31.12.2028	40
C26	Cercetător Științific gradul II_5	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	250	15.07.2026-31.12.2028	12
C27	Cercetător Științific gradul II_6	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	250	15.07.2026-31.12.2028	40
C28	Cercetător Științific gradul II_7	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	250	15.07.2026-31.12.2028	30
C29	Cercetător Științific gradul II_8	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	250	15.07.2026-31.12.2028	20
C30	Cercetător Științific gradul II_9	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	250	15.07.2026-31.12.2028	60
C31	Cercetător Științific gradul II_10	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	250	15.07.2026-31.12.2028	40
C32	Cercetător Științific gradul II_11	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	250	15.07.2026-31.12.2028	20
C33	Cercetător Științific gradul II_12	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	250	15.07.2026-31.12.2028	40
C34.1-34.2	Cercetător Științific gradul III_11	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	2	175	15.07.2026-31.12.2028	20
C35	Cercetător Științific gradul III_12	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	175	15.07.2026-31.12.2028	60
C36	Cercetător Științific gradul III_13	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	175	15.07.2026-31.12.2028	40



C37	Cercetător Științific gradul III_14	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	175	15.07.2026-31.12.2028	60
C38	Cercetător Științific gradul III_15	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	175	15.07.2026-31.12.2028	30
C39	Inginer_6	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	125	15.07.2026-31.12.2028	40
C40	Inginer_7	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	125	15.07.2026-31.12.2028	40
C41	Inginer_8	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	125	15.07.2026-31.12.2028	60
C42	Inginer_9	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	125	15.07.2026-31.12.2028	40
C43	Inginer_10	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	125	15.07.2026-31.12.2028	80
C44	Inginer_11	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	125	15.07.2026-31.12.2028	20
C45	Inginer_12	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	125	15.07.2026-31.12.2028	40
C46.1-C46.2	Tehnician_3	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	2	75	15.07.2026-31.12.2028	80
C47.1-C47.3	Tehnician_4	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	3	75	15.07.2026-31.12.2028	40
C48	Tehnician_5	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	1	75	15.07.2026-31.12.2028	60
C49	Tehnician_6	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	2	75	15.07.2026-31.12.2028	60

¹Perioada de angajare este conform perioadei de implementare a proiectului și prevederilor cererii de finanțare aprobate. În cazul în care este necesară prelungirea perioadei de activitate, aceasta se va modifica prin acordul părților, în baza unui act adițional la Contractul Individual de Muncă.

²Timpul de lucru se poate modifica prin acordul părților, în baza unui act adițional la Contractul Individual de Muncă, în funcție de activitățile proiectului.

Intervalul orar în care se poate desfășura activitatea este 06:00 – 22:00, programul de lucru având caracter flexibil, în funcție de specificul postului, fără a se suprapune programele de lucru în cazul cumulului. Activitatea va fi remunerată lunar, proporțional cu timpul lucrat de către angajat, pe baza documentelor de raportare/conform procedurilor specifice ale proiectului și ținând cont de legislația în vigoare și prevederile/instrucțiunile/ordinele etc. aplicabile proiectului.

A. Condițiile generale de participare la examen, conform legislație în vigoare, sunt:

- a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 - prin excepție de la condiția prevăzută la lit. a) pot fi angajați și cetățeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceștia prin legislația specifică și legislația muncii (atestatul de recunoaștere a diplomei de studii, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Studiilor. Dacă țara care a emis diploma de studii nu este semnatară a Convenției de la Haga, caz în care este necesară apostilarea diplomei, sau nu a semnat cu România un tratat de recunoaștere reciprocă a actelor, atunci este

necesară supralegalizarea diplomei, codul COR aferent funcției pe care se dorește angajarea trebuie să fie compatibil cu studiile cetățeanului străin, așa cum au fost ele recunoscute de instituția competentă)

- b) cunoaște limba română, scris și vorbit sau o limbă de circulație internațională;
- c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) *are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la examen;
- f) *nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- g) *nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
- h) *nu a comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completare Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h

**În cazul cetățenilor străini, pentru atestarea îndeplinirii condițiilor stipulate la punctele d), f), g), respectiv h) este necesară completarea unei declarații pe propria răspundere.*

Actele necesare înscrierii sunt:

- a) formular de înscriere la examen <https://posturivacante.upb.ro/cercetare/>, în original;
- b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
- c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
- d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat prin prezentul anunț;
- e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
- f) cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, în original. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice;
- g) certificatul de integritate comportamentală, în original, din care să reiasă că nu s-a comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Juridice, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din sistemului de învățământ, sănătate sau protecție social, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

h) certificat medical eliberat de către medicul specialist de medicina muncii eliberat în baza avizului medical emis de către medicul specialist psihiatru și a adeverinței medicale eliberate de către medicul de familie, în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, cu mențiunea apt pentru concurs. Dacă informațiile prezentate în certificat se dovedesc a fi neconforme, documentul va fi considerat nul;

i) certificatul care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, certificatul care atestă starea de sănătate trebuie însoțit de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii (copia certificatului se prezintă însoțită de documentul original, pentru certificarea cu mențiunea „conform cu originalul”);

j) curriculum vitae, model comun european, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat.

În situația în care, POLITEHNICA București întreprinde toate diligențele pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar, respectiv a certificatului de integritate comportamentală, și la eliberarea documentelor, de către autoritățile competente, se constată încălcarea condițiilor generale de participare la examenul de ocupare a postului, candidatul va fi exclus din cadrul examenului în orice etapă a acestuia și/sau nu va fi încadrat pe post.

Înscrierile se fac până la data de **22.06.2026**, inclusiv, ora 14⁰⁰ - UTC +2 Eastern European Time (EET).

- fie la sediul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, cod poștal 060042, clădire Rectorat, etaj 1, camera 114, telefon 021.402.9234,
- fie încărcat, în format electronic, la adresa resurse.umane@upb.ro, respectând prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Transmiterea documentelor prin poșta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă și să nu existe informații sub formă de link în corpul e-mail-ului.

Orice document asumat în nume propriu de către candidat, transmis prin poșta electronică (formular de înscriere, declarație pe propria răspundere etc.), va fi semnat utilizând semnătura electronică avansată sau calificată.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de examen, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Nerespectarea termenului de depunere a dosarelor de examen și a formatului menționat, după caz, conduce la respingerea candidatului.

Toate documentele se depun în limba română.

Candidatul declarat admis are obligația de a prezenta secretarului comisiei de evaluare și selecție originalele documentelor prezentate în copie în vedere certificării „conform cu originalul”, dacă acest lucru îi este solicitat, conform procedurilor specifice fiecărui proiect.

B. Condițiile specifice de participare la concurs pentru postrile vacante scoase la concurs, conform specificației Fișei Postului sunt:

Nr. Crt.	Funcție	Nr. posturi	Condiții minime obligatorii	Criterii suplimentare de selecție
1	Cercetător Științific gradul I_4	1	<p>1.Deținerea gradului de cercetător științific I sau echivalent - 10 pct</p> <p>2.Studii superioare de doctorat în inginerie electronică, telecomunicații, radiotehnică și radiocomunicații, calculatoare, mecatronică sau similar - 10 pct</p> <p>3.Experiență profesională de minimum 10 ani în inginerie electronică, telecomunicații, radiotehnică și radiocomunicații, calculatoare, mecatronică sau similar - 20 pct</p> <p>4.Experiență de cercetare demonstrată prin publicații științifice relevante (minim 10 publicații în domeniul: electronică, telecomunicații, radiotehnică și radiocomunicații, calculatoare, mecatronică sau similar) - 20 pct</p>	<p>Participare în proiecte/granturi naționale/internaționale de cercetare: minim 4 proiecte - 20 pct</p> <p>Suplimentar 20 publicații în domeniul ingineriei electronice, microelectronice, telecomunicații, radiotehnică și radiocomunicații, mecatronice, calculatoarelor sau similar- 20 pct</p>
2	Cercetător Științific gradul II_5	1	<p>1.Deținerea gradului de cercetător științific II sau echivalent - 10 pct</p> <p>2.Studii superioare de doctorat în inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar - 10 pct</p> <p>3.Experiență profesională de minimum 8 ani în inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar - 20 pct</p> <p>4.Experiență de cercetare demonstrată prin publicații științifice relevante (minim 10 publicații în domeniul:inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar) - 20 pct</p>	<p>Participare în proiecte/granturi naționale/internaționale de cercetare: minim 1 proiect - 20 pct.</p> <p>Suplimentar 15 publicații în domeniul inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar- 20 pct.</p>
3	Cercetător Științific gradul II_6	1	<p>1.Deținerea gradului de cercetător științific II sau echivalent - 10 pct</p> <p>2.Studii superioare de doctorat în inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar - 10 pct</p> <p>3.Experiență profesională de minimum 8 ani în inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar - 20 pct</p> <p>4.Experiență de cercetare demonstrată prin publicații științifice relevante (minim 10 publicații în domeniul:inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar) - 20 pct</p>	<p>Participare în proiecte/granturi naționale/internaționale de cercetare: minim 1 proiect - 20 pct.</p> <p>Suplimentar 15 publicații în domeniul inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar- 20 pct.</p>

4	Cercetător Științific gradul II_7	1	<p>1.Deținerea gradului de cercetător științific II sau echivalent - 10 pct</p> <p>2.Studii superioare de doctorat în inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar - 10 pct</p> <p>3.Experiență profesională de minimum 8 ani în inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar - 20 pct</p> <p>4.Experiență de cercetare demonstrată prin publicații științifice relevante (minim 10 publicații în domeniul: inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar) - 20 pct</p>	<p>Participare în proiecte/granturi naționale/internaționale de cercetare: minim 1 proiect - 20 pct.</p> <p>Suplimentar 15 publicații în domeniul inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar- 20 pct.</p>
5	Cercetător Științific gradul II_8	1	<p>1.Deținerea gradului de cercetător științific II sau echivalent - 10 pct</p> <p>2.Studii superioare de doctorat în inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar - 10 pct</p> <p>3.Experiență profesională de minimum 8 ani în inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar - 20 pct</p> <p>4.Experiență de cercetare demonstrată prin publicații științifice relevante (minim 10 publicații în domeniul: inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar) - 20 pct</p>	<p>Participare în proiecte/granturi naționale/internaționale de cercetare: minim 1 proiect - 20 pct.</p> <p>Suplimentar 15 publicații în domeniul inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar- 20 pct.</p>
6	Cercetător Științific gradul II_9	1	<p>1.Deținerea gradului de cercetător științific II sau echivalent - 10 pct</p> <p>2.Studii superioare de doctorat în inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar - 10 pct</p> <p>3.Experiență profesională de minimum 8 ani în inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar - 20 pct</p> <p>4.Experiență de cercetare demonstrată prin publicații științifice relevante (minim 10 publicații în domeniul: inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar) - 20 pct</p>	<p>Participare în proiecte/granturi naționale/internaționale de cercetare: minim 1 proiect - 20 pct.</p> <p>Suplimentar 15 publicații în domeniul inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar- 20 pct.</p>

7	Cercetător Științific gradul II_10	1	<p>1.Deținerea gradului de cercetător științific II sau echivalent - 10 pct</p> <p>2.Studii superioare de doctorat în inginerie electronică, mecanică, calculatoare, mecatronică sau similar - 10 pct</p> <p>3.Experiență profesională de minimum 8 ani în inginerie electronică, mecanică, calculatoare, mecatronică sau similar - 20 pct</p> <p>4.Experiență de cercetare demonstrată prin publicații științifice relevante (minim 10 publicații în domeniul: electronică, mecanică, calculatoare, mecatronică sau similar) - 20 pct</p>	<p>Participare în proiecte/granturi naționale/internaționale de cercetare: minim 1 proiect - 20 pct.</p> <p>Suplimentar 15 publicații în domeniul ingineriei electronice, microelectronice, mecatronice sau mecanice, calculatoarelor sau similar- 20 pct.</p>
8	Cercetător Științific gradul II_11	1	<p>1.Deținerea gradului de cercetător științific II sau echivalent - 10 pct</p> <p>2.Studii superioare de doctorat în inginerie electronică, mecanică, calculatoare, mecatronică sau similar - 10 pct</p> <p>3.Experiență profesională de minimum 8 ani în inginerie electronică, mecanică, calculatoare, mecatronică sau similar - 20 pct</p> <p>4.Experiență de cercetare demonstrată prin publicații științifice relevante (minim 10 publicații în domeniul: electronică, mecanică, calculatoare, mecatronică sau similar) - 20 pct</p>	<p>Participare în proiecte/granturi naționale/internaționale de cercetare: minim 1 proiect - 20 pct.</p> <p>Suplimentar 15 publicații în domeniul ingineriei electronice, microelectronice, mecatronice sau mecanice, calculatoarelor sau similar- 20 pct.</p>
9	Cercetător Științific gradul II_12	1	<p>1.Deținerea gradului de cercetător științific II sau echivalent - 10 pct</p> <p>2.Studii superioare de doctorat în inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar - 10 pct</p> <p>3.Experiență profesională de minimum 8 ani în inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar - 20 pct</p> <p>4.Experiență de cercetare demonstrată prin publicații științifice relevante (minim 10 publicații în domeniul: inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar) - 20 pct</p>	<p>Participare în proiecte/granturi naționale/internaționale de cercetare: minim 1 proiect - 20 pct.</p> <p>Suplimentar 15 publicații în domeniul inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar- 20 pct.</p>
10	Cercetător Științific gradul III_11	2	<p>1.Deținerea gradului de cercetător științific III sau echivalent - 10 pct</p> <p>2.Studii superioare de doctorat în inginerie electronică, mecanică, calculatoare, mecatronică sau similar - 10 pct</p> <p>3.Experiență profesională de minimum 8 ani în inginerie electronică, mecanică, calculatoare, mecatronică sau similar - 20 pct</p> <p>4.Experiență de cercetare demonstrată prin publicații științifice relevante (minim 10 publicații în domeniul: electronică, mecanică, calculatoare, mecatronică sau similar) - 20 pct</p>	<p>Participare în proiecte/granturi naționale/internaționale de cercetare: minim 1 proiect - 20 pct.</p> <p>Suplimentar 10 publicații în domeniul inginerie electronică, informatică, automatică, calculatoare, microelectronică, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar- 20 pct.</p>

11	Cercetător Științific gradul III_12	1	<p>1.Deținerea gradului de cercetător științific III sau echivalent - 10 pct</p> <p>2.Studii superioare de doctorat în inginerie electronică, mecanică, calculatoare, mecatronică sau similar - 10 pct</p> <p>3.Experiență profesională de minimum 8 ani în inginerie electronică, mecanică, calculatoare, mecatronică sau similar - 20 pct</p> <p>4.Experiență de cercetare demonstrată prin publicații științifice relevante (minim 10 publicații în domeniul: electronică, mecanică, calculatoare, mecatronică sau similar) - 20 pct</p>	<p>Participare în proiecte/granturi naționale/internaționale de cercetare: minim 1 proiect - 20 pct.</p> <p>Suplimentar 10 publicații în domeniul ingineriei electronice, microelectronice, mecatronice sau mecanice, calculatoarelor sau similar- 20 pct.</p>
12	Cercetător Științific gradul III_13	1	<p>1.Deținerea gradului de cercetător științific III sau echivalent - 10 pct</p> <p>2.Studii superioare de doctorat în inginerie electronică, mecanică, calculatoare, mecatronică sau similar - 10 pct</p> <p>3.Experiență profesională de minimum 8 ani în inginerie electronică, mecanică, calculatoare, mecatronică sau similar - 20 pct</p> <p>4.Experiență de cercetare demonstrată prin publicații științifice relevante (minim 10 publicații în domeniul: electronică, mecanică, calculatoare, mecatronică sau similar) - 20 pct</p>	<p>Participare în proiecte/granturi naționale/internaționale de cercetare: minim 1 proiect - 20 pct.</p> <p>Suplimentar 10 publicații în domeniul ingineriei electronice, microelectronice, mecatronice sau mecanice, calculatoarelor sau similar- 20 pct.</p>
13	Cercetător Științific gradul III_14	1	<p>1.Deținerea gradului de cercetător științific III sau echivalent - 10 pct</p> <p>2.Studii superioare de doctorat în ingineria calculatoarelor, microelectronica, tehnologia informației, electronica, automatica, mecanica sau similar - 10 pct</p> <p>3.Experiența profesională de minimum 8 ani în domeniul ingineria calculatoarelor, microelectronica, tehnologia informației, electronica, automatica, mecanica sau similar - 20 pct</p> <p>4.Experiență de cercetare demonstrată prin publicații științifice relevante (minim 10 publicații în domeniul ingineria calculatoarelor, microelectronica, tehnologia informației, electronica, automatica, mecanica sau similar) - 20 pct</p>	<p>Participare în proiecte/granturi naționale/internaționale de cercetare: minim 1 proiecte - 20 pct.</p> <p>10 publicații suplimentare în domeniul ingineria calculatoarelor, microelectronica, tehnologia informației, electronica, automatica, mecanica sau similar- 20 pct.</p>
14	Cercetător Științific gradul III_15	1	<p>1.Deținerea gradului de cercetător științific III sau echivalent - 10 pct</p> <p>2.Studii superioare de doctorat în ingineria calculatoarelor, microelectronica, tehnologia informației, electronica, automatica, mecanica, inginerie industrială sau similar - 10 pct</p> <p>3.Experiența profesională de minimum 8 ani în domeniul ingineria calculatoarelor, microelectronica, tehnologia informației, electronica, automatica, mecanica, inginerie industrială sau similar - 20 pct</p> <p>4.Experiență de cercetare demonstrată prin publicații științifice relevante (minim 10 publicații în domeniul ingineria calculatoarelor, microelectronica, tehnologia informației, electronica, automatica, mecanica, inginerie industrială sau similar) - 20 pct</p>	<p>Participare în proiecte/granturi naționale/internaționale de cercetare: minim 1 proiecte - 20 pct.</p> <p>10 publicații suplimentare în domeniul ingineria calculatoarelor, microelectronica, tehnologia informației, electronica, automatica, mecanica sau similar- 20 pct.</p>

15	Inginer_6	1	<p>1.Studii de specialitate la nivel de master sau echivalent în domenii precum: Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar – 30 pct</p> <p>2.Candidații trebuie să demonstreze că sunt înscriși la/au finalizat studii la o școală doctorală din România, având o temă de cercetare legată de: Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar – 30 pct</p>	<p>Minim 1 publicatie in domeniul Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar 40 pct</p>
16	Inginer_7	1	<p>1.Studii de specialitate la nivel de master sau echivalent în domenii precum: Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar – 30 pct</p> <p>2.Candidații trebuie să demonstreze că sunt înscriși la/au finalizat studii la o școală doctorală din România, având o temă de cercetare legată de: Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar – 30 pct</p>	<p>Minim 1 publicatie in domeniul Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar 40 pct</p>
17	Inginer_8	1	<p>1.Studii de specialitate la nivel de master sau echivalent în domenii precum: Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar – 30 pct</p> <p>2.Candidații trebuie să demonstreze că sunt înscriși la/au finalizat studii la o școală doctorală din România, având o temă de cercetare legată de: Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar – 30 pct</p>	<p>Minim 1 publicatie in domeniul Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar 40 pct</p>
18	Inginer_9	1	<p>1.Studii de specialitate la nivel de master sau echivalent în domenii precum: Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar – 30 pct</p> <p>2.Candidații trebuie să demonstreze că sunt înscriși la/au finalizat studii la o școală doctorală din România, având o temă de cercetare legată de: Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar – 30 pct</p>	<p>Minim 1 publicatie in domeniul Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar 40 pct</p>

19	Inginer_10	1	<p>1.Studii de specialitate la nivel de master sau echivalent în domenii precum: Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar – 30 pct</p> <p>2.Candidații trebuie să demonstreze că sunt înscriși la/au finalizat studii la o școală doctorală din România, având o temă de cercetare legată de: Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar – 30 pct</p>	<p>Minim 1 publicatie in domeniul Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar 40 pct</p>
20	Inginer_11	1	<p>1.Studii de specialitate la nivel de master sau echivalent în domenii precum: Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar – 30 pct</p> <p>2.Candidații trebuie să demonstreze că sunt înscriși la/au finalizat studii la o școală doctorală din România, având o temă de cercetare legată de: Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar – 30 pct</p>	<p>Minim 1 publicatie in domeniul Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar 40 pct</p>
21	Inginer_12	1	<p>1.Studii de specialitate la nivel de master sau echivalent în domenii precum: Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar – 30 pct</p> <p>2.Candidații trebuie să demonstreze că sunt înscriși la/au finalizat studii la o școală doctorală din România, având o temă de cercetare legată de: Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar – 30 pct</p>	<p>Minim 1 publicatie in domeniul Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar 40 pct</p>
22	Tehnician_3	2	<p>1.Diploma de bacalaureat - 20pct</p> <p>2.Candidații trebuie să demonstreze că au finalizat sau sunt înscriși la studii superioare la o facultate de Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar. – 30 pct</p> <p>3.Recomandare de la coordonatorul de an/profesor îndrumător proiect licenta care să ateste aptitudinile practice și seriozitatea candidatului – 10 pct</p>	<p>Student în anul III/IV al unui program de licența în Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar 20 pct</p> <p>Diplomă de licență în Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar 20 pct</p>

23	Tehnician_4	3	<p>1.Diploma de bacalaureat – 20 pct</p> <p>2.Candidații trebuie să demonstreze că au finalizat sau sunt înscriși la studii superioare la o facultate de Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar. – 30 pct</p> <p>3.Recomandare de la coordonatorul de an/profesor îndrumător proiect licenta care să ateste aptitudinile practice și seriozitatea candidatului – 10 pct</p>	<p>Student în anul III/IV al unui program de licență în Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar 20 pct</p> <p>Diplomă de licență în Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar 20 pct</p>
24	Tehnician_5	1	<p>1.Diploma de bacalaureat – 20 pct</p> <p>2.Candidații trebuie să demonstreze că au finalizat sau sunt înscriși la studii superioare la o facultate de Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar – 30 pct</p> <p>3.Recomandare de la coordonatorul de an/profesor îndrumător proiect licenta care să ateste aptitudinile practice și seriozitatea candidatului – 10 pct</p>	<p>Student în anul III/IV al unui program de licență în Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar 20 pct</p> <p>Diplomă de licență în Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar 20 pct</p>
25	Tehnician_6	2	<p>1.Diploma de bacalaureat - 20pct</p> <p>2.Candidații trebuie să demonstreze că au finalizat sau sunt înscriși la studii superioare la o facultate de Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar. – 30 pct</p> <p>3.Recomandare de la coordonatorul de an/profesor îndrumător proiect licenta care să ateste aptitudinile practice și seriozitatea candidatului – 10 pct</p>	<p>Student în anul III/IV al unui program de licență în Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar 20 pct</p> <p>Diplomă de licență în Inginerie, cu specializare în electronică, informatica, automatica, microelectronica, mecatronică, mecanică, știința materialelor sau similar 20 pct</p>

C. Concursul constă în:

1. Evaluarea dosarelor de candidatură.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a îndeplinit condițiile minime obligatorii menționate la punctul B.

În situația în care sunt declarați admiși mai mulți candidați pe același post, aceștia vor fi invitați la proba interviu în urma căreia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.

2. Interviu (probă opțională) – se va susține doar în situația în care, sunt declarați admiși mai mulți candidați pe același post la proba evaluării dosarelor – pe baza grilei de evaluare a următoarelor competențe:

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:	
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;	50 puncte
b) capacitatea de analiză și sinteză;	20 puncte
c) motivația candidatului;	10 puncte

d) comportamentul în situațiile de criză;	10 puncte
e) inițiativă și creativitate.	10 puncte

Se consideră selectat pentru ocuparea postului vacant, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba evaluării dosarelor și proba interviu.

D. Bibliografia: în cazul probelor opționale

Cercetator Stiintific I_4

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.

32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Cercetător Științific gradul II_5

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.



29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologiile de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.
41. Bojin, D., Miculescu, F., & Miculescu, M. (2005). Microscopie electronică de baleiaj și aplicații, Editura Agir.;
42. Saban, R., Bunea, D., Vasile, T., Branzei, M., Gheorghe, D., Ionita, Gh.; “Studiul și ingineria materialelor”, Ed.Didactica și Pedagogica, București;
43. Zamfir, S., Vidu, R., & Brinzoi, V. . (2002). Coroziunea materialelor metalice. Editura Didactica și Pedagogica.

Cercetător Științific gradul II_6

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.



20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Cercetător Științific gradul II_7

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.



16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Cercetător Științific gradul II_8

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.

12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Cercetător Științific gradul II_9

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.



8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Cercetător Științific gradul II_10

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.



4. Bach, M. J. (1986). *The Design of the UNIX Operating System*. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). *Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications*. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). *FPGA Prototyping by VHDL Examples*. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). *Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers*. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). *Measurement Systems: Application and Design* (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. *ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet*.
12. Furber, S. (2000). *ARM System-on-Chip Architecture*. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
16. Guvernul României. *Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare*.
17. Horizon Europe. *Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare*.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer* (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). *Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment*. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). *Thermal Management for LED Applications*. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). *Capitolele privind cercetarea științifică*.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). *A Heat Transfer Textbook* (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). *Mastering Algorithms with C*. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). *Python for Data Analysis*. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). *Design and Analysis of Experiments* (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). *Digital Signal Processing*. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). *Electromagnetic Compatibility Engineering*. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). *Introduction to Electromagnetic Compatibility* (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. *Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT)*.
31. Pryor, R. W. (2011). *Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach*. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. *RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico*.
33. Ravariu, C. (2004). *Dispozitive Electronice*. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). *An Introduction to the Finite Element Method* (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). *Engineering Analysis with ANSYS Software*. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. *AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual*.
37. Valvano, J. W. (2011). *Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers*.
38. Wirth, N. (1985). *Algorithms + Data Structures = Programs*. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. *Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență*.

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologiile de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.

39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. *Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență*.

Cercetător Științific gradul II_12

1. Ansys Learning Hub. *Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice*.
2. ARM Ltd. *ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual*.
3. Autodesk Learning Resources. *Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare*.
4. Bach, M. J. (1986). *The Design of the UNIX Operating System*. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). *Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications*. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). *FPGA Prototyping by VHDL Examples*. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). *Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers*. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. *Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică*.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). *Measurement Systems: Application and Design* (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. *ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet*.
12. Furber, S. (2000). *ARM System-on-Chip Architecture*. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
16. Guvernul României. *Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare*.
17. Horizon Europe. *Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare*.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer* (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). *Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment*. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). *Thermal Management for LED Applications*. Springer.
21. *Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică*.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). *A Heat Transfer Textbook* (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). *Mastering Algorithms with C*. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). *Python for Data Analysis*. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). *Design and Analysis of Experiments* (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). *Digital Signal Processing*. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). *Electromagnetic Compatibility Engineering*. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). *Introduction to Electromagnetic Compatibility* (2nd ed.). Wiley.
30. PIIIEC/IPCEI. *Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT)*.
31. Pryor, R. W. (2011). *Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach*. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. *RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico*.
33. Ravariu, C. (2004). *Dispozitive Electronice*. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). *An Introduction to the Finite Element Method* (4th ed.). McGraw-Hill.

35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.;
41. Bojin, D., Miculescu, F., & Miculescu, M. (2005). Microscopie electronică de baleiaj și aplicații, Editura Agir.;
42. Saban, R., Bunea, D., Vasile, T., Branzei, M., Gheorghe, D., Ionita, Gh.; “Studiul si ingineria materialelor”, Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti;
43. Zamfir, S., Vidu, R., & Brinzoi, V. . (2002). Coroziunea materialelor metalice. Editura Didactica si Pedagogica.

Cercetator Stiintific III_11

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.

27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologiile de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Cercetator Stiintific III_12

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.

22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Cercetator Stiintific III_13

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.



19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Cercetator Stiintific III_14

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.

15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologiile de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Cercetator Stiintific III_15

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.



11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Inginer_6

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.



8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.
41. Bojin, D., Miculescu, F., & Miculescu, M. (2005). Microscopie electronică de baleiaj și aplicații, Editura Agir.;
42. Saban, R., Bunea, D., Vasile, T., Branzei, M., Gheorghe, D., Ionita, Gh.; “Studiul si ingineria materialelor”, Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti;
43. Zamfir, S., Vidu, R., & Brinzoii, V. . (2002). Coroziunea materialelor metalice. Editura Didactica si Pedagogica

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologiile de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.

39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. *Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență*.

Inginer_8

1. Ansys Learning Hub. *Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice*.
2. ARM Ltd. *ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual*.
3. Autodesk Learning Resources. *Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare*.
4. Bach, M. J. (1986). *The Design of the UNIX Operating System*. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). *Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications*. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). *FPGA Prototyping by VHDL Examples*. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). *Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers*. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. *Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică*.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). *Measurement Systems: Application and Design* (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. *ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet*.
12. Furber, S. (2000). *ARM System-on-Chip Architecture*. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
16. Guvernul României. *Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare*.
17. Horizon Europe. *Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare*.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer* (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). *Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment*. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). *Thermal Management for LED Applications*. Springer.
21. *Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică*.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). *A Heat Transfer Textbook* (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). *Mastering Algorithms with C*. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). *Python for Data Analysis*. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). *Design and Analysis of Experiments* (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). *Digital Signal Processing*. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). *Electromagnetic Compatibility Engineering*. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). *Introduction to Electromagnetic Compatibility* (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. *Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT)*.
31. Pryor, R. W. (2011). *Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach*. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. *RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico*.
33. Ravariu, C. (2004). *Dispozitive Electronice*. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). *An Introduction to the Finite Element Method* (4th ed.). McGraw-Hill.

35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Inginer_9

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT).

31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Inginer_10

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.

27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologiile de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Inginer_11

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.



22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Inginer_12

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Resiliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.



19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Tehnician_3

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.

15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologiile de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Tehnician_4

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.



11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Tehnician_5

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.
4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.

8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

Tehnician_6

1. Ansys Learning Hub. Cursuri oficiale pentru simulări termice, mecanice și electromagnetice.
2. ARM Ltd. ARM Cortex-M0+ Technical Reference Manual.
3. Autodesk Learning Resources. Resurse pentru modelare CAD și pregătirea geometriilor pentru simulare.



4. Bach, M. J. (1986). The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall.
5. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
6. Caloz, C., & Itoh, T. (2006). Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications. Wiley.
7. Chu, P. P. (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples. Wiley.
8. Coleman, H. W., & Steele, W. G. (2018). Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers. Wiley.
9. COMSOL Knowledge Base. Articole tehnice și tutoriale pentru modelarea multifizică.
10. Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2019). Measurement Systems: Application and Design (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual & Datasheet.
12. Furber, S. (2000). ARM System-on-Chip Architecture. Addison-Wesley.
13. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
14. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2017). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
15. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
16. Guvernul României. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Capitolele pentru cercetare și digitalizare.
17. Horizon Europe. Programme Guide – Ghidul oficial pentru cercetare și inovare.
18. Incropera, F. P., et al. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley.
19. Kraus, A. D., & Bar-Cohen, A. (1983). Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment. Hemisphere.
20. Lasance, C. J. M., & Poppe, A. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
21. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată). Capitolele privind cercetarea științifică.
22. Lienhard, J. H., & Lienhard, J. H. (2020). A Heat Transfer Textbook (5th ed.). Phlogiston Press.
23. Loudon, K. (1999). Mastering Algorithms with C. O'Reilly Media.
24. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.
25. Menezes, A. J., et al. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.
26. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th ed.). Wiley.
27. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (1996). Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
28. Ott, H. W. (2009). Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley.
29. Paul, C. R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd ed.). Wiley.
30. PIIEC/IPCEI. Planul de implementare în Microelectronică și Tehnologii de Comunicații (ME/CT).
31. Pryor, R. W. (2011). Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principles Approach. Jones & Bartlett.
32. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet & Hardware Design with Raspberry Pi Pico.
33. Ravariu, C. (2004). Dispozitive Electronice. Ed. Printech.
34. Reddy, J. N. (2019). An Introduction to the Finite Element Method (4th ed.). McGraw-Hill.
35. Stolarski, T., et al. (2018). Engineering Analysis with ANSYS Software. Butterworth-Heinemann.
36. Texas Instruments. AM62x Sitara Processors Technical Reference Manual.
37. Valvano, J. W. (2011). Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers.
38. Wirth, N. (1985). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall.
39. Zienkiewicz, O. C., et al. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Butterworth-Heinemann.
- 40. [Referință Generală]. Proiectarea PCB-urilor: Tehnici moderne și integritatea semnalului în circuite de înaltă frecvență.

E. Tematica (se stabilește pe baza bibliografiei): în cazul probelor opționale

Cercetator Stiintific I_4

- Cercetarea, proiectarea și caracterizarea materialelor noi și a metamaterialelor cu proprietăți electromagnetice controlate, pentru aplicații în microelectronică, simulări în ANSYS HFSS pentru antene și elemente radiante, testare echipamente în domeniul TEMPEST, testare echipamente în domeniul EMC (ecranare EMI, absorbție microunde, disipare termică)..

Cercetător Științific gradul II_5

- Proiectarea și simularea sistemelor mecanice, electrice sau mecatronice

Cercetător Științific gradul II_6

- Proiectarea și simularea sistemelor mecanice, electrice sau mecatronice

Cercetător Științific gradul II_7

- Proiectarea și simularea sistemelor mecanice, electrice sau mecatronice

Cercetător Științific gradul II_8

- Proiectarea și simularea sistemelor mecanice, electrice sau mecatronice

Cercetător Științific gradul II_9

- Proiectarea și simularea sistemelor mecanice, electrice sau mecatronice

Cercetător Științific gradul II_10

- Sisteme inteligente avansate
- Analiza și modelarea sistemelor

Cercetător Științific gradul II_11

- Cercetarea, proiectarea și caracterizarea materialelor noi și a metamaterialelor cu proprietăți electromagnetice controlate, pentru aplicații în microelectronică, simulări în ANSYS HFSS pentru antene și elemente radiante, testare echipamente în domeniul TEMPEST, testare echipamente în domeniul EMC (ecranare EMI, absorbție microunde, disipare termică).

Cercetător Științific gradul II_12

- Proiectarea și simularea sistemelor mecanice, electrice sau mecatronice

Cercetator Stiintific III_11

- Cercetarea, proiectarea și caracterizarea materialelor noi și a metamaterialelor cu proprietăți electromagnetice controlate, pentru aplicații în microelectronică, simulări în ANSYS HFSS pentru antene și elemente radiante, testare echipamente în domeniul TEMPEST, testare echipamente în domeniul EMC (ecranare EMI, absorbție microunde, disipare termică).

Cercetator Stiintific III_12

- Cercetarea, proiectarea și caracterizarea materialelor noi și a metamaterialelor cu proprietăți electromagnetice controlate, pentru aplicații în microelectronică, simulări în ANSYS HFSS pentru antene și elemente radiante, testare echipamente în domeniul

TEMPEST, testare echipamente în domeniul EMC (ecranare EMI, absorbție microunde, disipare termică).

Cercetator Stiintific III_13

- Cercetarea, proiectarea și caracterizarea materialelor noi și a metamaterialelor cu proprietăți electromagnetice controlate, pentru aplicații în microelectronică, simulări în ANSYS HFSS pentru antene și elemente radiante, testare echipamente în domeniul TEMPEST, testare echipamente în domeniul EMC (ecranare EMI, absorbție microunde, disipare termică).

Cercetator Stiintific III_14

- Proiectarea și simularea sistemelor mecanice, electrice sau mecatronice

Cercetator Stiintific III_15

- Proiectarea și simularea sistemelor mecanice, electrice sau mecatronice

Inginer_6

- Proiectarea și simularea sistemelor mecanice, electrice sau mecatronice

Inginer_7

- Cercetarea, proiectarea și caracterizarea materialelor noi și a metamaterialelor cu proprietăți electromagnetice controlate, pentru aplicații în microelectronică, simulări în ANSYS HFSS pentru antene și elemente radiante, testare echipamente în domeniul TEMPEST, testare echipamente în domeniul EMC (ecranare EMI, absorbție microunde, disipare termică).

Inginer_8

- Programare și algoritmi
- Sisteme embedded
- Prelucrarea datelor
- Inteligență artificială – nivel introductiv
- Prelucrarea semnalelor și imaginilor
- Hardware reconfigurabil
- Validare experimentală

Inginer_9

- Programare și algoritmi
- Sisteme embedded
- Prelucrarea datelor
- Inteligență artificială – nivel introductiv
- Prelucrarea semnalelor și imaginilor
- Hardware reconfigurabil
- Validare experimentală

Inginer_10

- Programare și algoritmi
- Sisteme embedded
- Prelucrarea datelor
- Inteligență artificială – nivel introductiv
- Prelucrarea semnalelor și imaginilor
- Hardware reconfigurabil
- Validare experimentală



Inginer_11

- Programare și algoritmi
- Sisteme embedded
- Prelucrarea datelor
- Inteligență artificială – nivel introductiv
- Prelucrarea semnalelor și imaginilor
- Hardware reconfigurabil
- Validare experimentală

Inginer_12

- Programare și algoritmi
- Sisteme embedded
- Prelucrarea datelor
- Inteligență artificială – nivel introductiv
- Prelucrarea semnalelor și imaginilor
- Hardware reconfigurabil
- Validare experimentală

Tehnician_3

- Programare embedded și sisteme hardware
- Inteligență artificială și machine learning
- Prelucrarea semnalelor și a imaginilor

Tehnician_4

- Programare embedded și sisteme hardware
- Inteligență artificială și machine learning
- Prelucrarea semnalelor și a imaginilor
- Algoritmi și structuri de date Proiectare hardware și sisteme mecatronice
- Criptografie și securitate hardware

Tehnician_5

- Programare embedded și sisteme hardware
- Inteligență artificială și machine learning
- Prelucrarea semnalelor și a imaginilor
- Algoritmi și structuri de date Proiectare hardware și sisteme mecatronice
- Criptografie și securitate hardware

Tehnician_6

- Programare embedded și sisteme hardware
- Inteligență artificială și machine learning
- Prelucrarea semnalelor și a imaginilor
- Algoritmi și structuri de date Proiectare hardware și sisteme mecatronice
- Criptografie și securitate hardware

Documentele necesare înscrierii și alte informații suplimentare se găsesc pe site-ul universității www.upb.ro sau la telefon 021.402.9234.



Datele de desfășurare a probelor de concurs:

18.06.2026	-	-depunerea dosarelor de înscriere la concurs
22.06.2026		
23.06.2026	-	-verificarea administrativă, selecție și evaluare dosare
24.06.2026		
25.06.2026		-afișarea rezultatelor parțiale (<i>proba evaluare dosare</i>) – până la ora 14.00
26.06.2026		-depunerea contestațiilor (<i>proba evaluare dosare</i>) – până la ora 14.00
		-afișarea soluționării contestațiilor (<i>proba evaluare dosare</i>)
29.06.2026		-programarea interviului (<i>în cazul în care sunt declarați admiși mai mulți candidați pe același post la evaluarea dosarelor</i>) - comunicarea rezultatelor finale (<i>în cazul în care nu se organizează proba interviu</i>)
30.06.2026		-proba interviu
01.07.2026		-afișarea rezultatelor (<i>proba interviu</i>)
02.07.2026		-depunerea contestațiilor (<i>proba interviu</i>)
		-soluționarea contestațiilor (<i>proba interviu</i>)
03.07.2026		-comunicarea rezultatelor finale

NOTĂ: Originalul documentului semnat se regăsește la sediul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Direcția Informatizare și Resurse Umane, Serviciul Evidența Resurselor Umane, clădirea Rectorat, cam. 114.

